

2017年5月31日リリース

プレスリリース

「SMT 業界の M2M 連携について」

一般社団法人 日本ロボット工業会では、電子回路基板製造装置及びその関連ソフトウェアを製造する事業者が製造装置間の通信方法(M2M 連携)に関して共同で規格を策定していく活動をパナソニック株式会社、富士機械製造株式会社、ヤマハ発動機株式会社、JUKI 株式会社等の会員企業をはじめとした下記18社と開始いたします。

現在の電子回路基板製造装置のラインには、一般的に印刷・検査・マウンタ・リフローなどのさまざまな装置と、それらをつなぐ搬送装置が存在し、かつそれらのメーカーが異なっている事が大半です。この場合、装置内の基板情報や生産情報の持ち方および他の装置との通信方法は各社独特で、ライン全体での一貫した情報管理はたいへん手間とコストがかかり、ユーザーの負担になっていました。

今回実装ラインに設置されたさまざまな製造装置間の通信ルールを標準化することで、企業の垣根を超えた実装システムをユーザーがシンプルに構築しやすくなり、生産管理の容易化・変種変量生産への迅速対応などのメリットと、メーカー各社にも M2M 連携のしやすさから新たな価値提供を生むチャンスとなります。

そして今回の活動を通じて、将来のさらなる実装業界の発展に貢献してまいります。

。

オムロン株式会社

小松電子株式会社

株式会社サキコーポレーション

千住金属工業株式会社

株式会社タムラ製作所

株式会社ナガオカ製作所

名古屋電機工業株式会社

パナソニック株式会社

富士機械製造株式会社

マイクロニックテクノロジーズ株式会社

マランツエレクトロニクス株式会社

武蔵エンジニアリング株式会社

ヤマハ発動機株式会社

ワイエス株式会社

CKD 株式会社

JUKI 株式会社

KOH YOUNG TECHNOLOGY INC

Parmi CO.,LTD

五十音順

本件問い合わせ先

(一社) 日本ロボット工業会 技術部